

2020 年度第 2 四半期 決算説明会 Q&A

(20Q2 は 2020 年度第 2 四半期、20F1 は 2020 年度上半期、20F は 2020 年度を示します)

【20Q2 実績・20F1 実績・20F 予想】

Q. 部品需要の過熱感とのことだが、20Q2 でどの用途でどのくらいの額が、実需より多い取込みだったか？
20Q4 まで売上が減少するが、それによって取り込んだ部分が解消・正常化して 21 年 3 月末を迎えるのか？

A. 主にスマートフォン、中華圏最大手メーカーの減少分を補うことを想定して、他のスマートフォンメーカーから強いオーダーが入っている。下期は保守的に見ている部分はあるが、過熱感は 3 月までには解消・正常化すると見込んでいる。

PC はセット台数の期初予想に対して、20F1 は巣ごもり需要で強かったが、下期は正常化する。車載は 20Q1 に大きく落ち込んだが、20Q2 に大きく回復、20F 通期でセット台数は YoY ▲15%を見込んでいる。

Q. 20Q3 以降、中華圏最大手メーカーへの売上は減少すると推察しているが、トータルで見ると売上はどうなるか？また 21F 以降、もう少し長い時間軸を見た場合の売上はどうか？

A. 米国商務省から 8 月中旬に新規発行された EAR の影響で、中華圏最大手メーカーの需要は 10 月以降、相当量下がっている。少なからず業績に影響があるが、その減少分を補う形で他のスマートフォンメーカーから強い要求を受けているので、20F 通期でセット台数は YoY ▲7%に落ち着くと思う。一時的には影響が出るものの、年度を通じてはスマートフォン全体の需要に対する影響はさほど大きくないと見ている。21F 以降については、5G のアタッチレートが業績に影響する。今秋から新しいモデルで 5G が搭載されており、その状況を見て見積もる。

Q. 中華圏最大手メーカーは特にモジュールで在庫の取込みをしたと考えている、金額のニュアンスを教えてください。

A. 個別の顧客についての金額影響は非開示。部品在庫を持ってそれで生産活動をしていると思う。影響は小さくないが、減少分は他社から過熱気味の需要が入っており、カバーできている。

Q. 中華圏最大手メーカーは自社製のチップを諦めて、他社製のチップを使って復活するのが一番ありえるシナリオだと思っている。今は他社がシェアを上げようとしているが、中華圏最大手メーカーが戻ってきたときのインパクトをシミュレーションしていれば教えてほしい。

A. プラットフォームの変更は十分想定できており、今の対応・供給能力で十分カバーできるところに収まると思う。今回少し上方修正したが、様々な環境を踏まえ、スマートフォンのセット台数前提は YoY ▲7%減としている。

【モジュール】

Q. 5Gのモジュールではフィルタ技術が重要になっている。LTCCのフィルタのほか、IPDも出てきている。現状、性能や形状を比較して、どういう選択をしているか？ XBAR[®]などの新しい技術をどう使っていくのか？

A. 5Gのトレンドの中で mandatory に入っているのが sub6 で、フィルタの技術としては今年のスペックに対しては LTCC を使った LC フィルタで対応しているものが多い。システムがマチュアになると近傍の減衰が厳しくなり、2022 年くらいを目途に急峻なフィルタに移行していく必要があるが、I.H.P. SAW や XBAR[®]といった技術で対応可能と考えている。

Q. 今 IPD のフィルタが出てきていると思うが、それに対する優位性は？どのような長所・短所を見てユーザーは選択しているのか？

A. IPD の長所は薄くできること。モジュール用なら IPD の方が使い勝手が良い。フィルタの基本特性を決める無負荷の Q 値は IPD も LC も大きな差異は無い。サイズの薄いものが要求される場合には IPD が使われ、コストベースではセラミックの LC の方が有利となる。

Q. 性能については、IPD も LC も大きく変わらないと思う。性能を上げるには共振を使うフィルタが必要になるのか？

A. その通り。おそらくこの 2 年間の sub6 のスペックについては、今の延長線上で対応可能。それ以降は近傍の周波数が妨害波になってくる。その減衰を考えると今の SAW フィルタよりも Q の高いものが必要になるため、XBAR[®]の技術を準備している。

Q. モジュールで挽回していきたいと 20Q1 の決算説明会で話していたが、20F2 でどう変わってきているか？どう予想に織り込んでいるか？

A. 台湾メーカーのプラットフォームでのリファレンスデザインについては、米国の競合に少し先行された部分があるが、並行してリファレンスデザインに入っている。中国の顧客の刈り取りもすでに開始しており、20F2 の予想に入れている。

Q. パワーアンプやスイッチ用の 8 インチのファウンドリのキャパがタイトになっていると聞く。来年の 5G の数量増を考えるとキャパの手当てが重要だと思うが、現在どのような戦略か？

A. パワーアンプでいうと、LTE のセルラーバンド・5G のバンド・Wi-Fi のバンドがあり、その中でセグメントを分けて、ガリヒ素の HBT を使うものとシリコンの SOI を使うものに分けている。SOI の CMOS の方がタイト感が強く、ファブを 2 社認定してリスクヘッジしており、今のところこの 2 社で来年の需要分もカバーできると考えている。ガリヒ素 HBT については台湾にファブがありその 1 社で十分なウェハ数を確保して進めていく。

Q. 期初予想比で、モジュールの減収幅が縮小している。Wi-Fi・メトロサーク・RF などに分けて教えてほしい。特に RF は米中摩擦による前倒し取込みが 20F1 にあったかと思うが、20F2、21F にどのような影響を与えるか？

A. 旧モデル品が 20F1 に相当量流動した。そのためメトロサークや Wi-Fi などが多く流動した。新モデル品では高周波や Wi-Fi のフロントエンドが多く流動している。21F 以降は 5G のアタッチレートをどう見るかが難しいが、現状では 5G sub6 はある程度 mandatory で入ってくる。それに対して精度のいいアンテナや伝送線路はメトロサークで対応できる部分がたくさんあるし、高周波モジュールも需要は高まっていく。

【コンデンサ】

Q. 21F に向けたコンデンサの能力増強・準備は？ 供給が不足したりタイトになる可能性はあるか？

A. 能力増強(生産負荷ベース)は 19F が+10%、20F が+5~10%。21F はまだ正確な計画はないが、+5~10%はしっかり実行したい。20Q4 の需要が強ければ若干の上積みもあり得る。

Q. MLCC について、現時点で需給にタイト感はあるか？

A. 20Q2 からかなり受注が戻ってきて小型品・先端領域の一部でタイト感が出ているが、顧客に迷惑をかけることにはなっていない。

Q. MLCC の 20Q3 以降の価格の変化はどう考えている？

A. 20F1 は値下がりマイルドだったが、コロナで業績が悪化している顧客も多く、価格協力の要請もあるので、20F2 は値下がりする方向。20Q4 は車載・電装部品メーカーの価格改定もある。

Q. 需給がタイトになっていく中で、20F2 でさらに値下がりするとは考えにくい。かなり保守的な前提の業績予想になっているのか？

A. 保守的というのがどの程度かということにもよるが、20F1 と比べると、20F2 は一定の値下がりを見込んでいる。

Q. MLCC は 21F 以降、3~5 年の中期で見たときに、数量や金額が年平均どのくらい拡大するか？

A. コロナが回復に向かえば、年間 10%程度の数量成長は期待したい。

Q. MLCC について、21F の小型大容量品と中高圧品の需要をどう見ているか？ それに対して能力付けは大丈夫か？ 21F は 20F より MLCC の投資は増える方向か？

A. 21F は自動車がしっかり戻ってきて、ミドルサイズの中圧品が増えると期待している。スマートフォン向けの小型品と中圧品が両輪になって伸びていくのが期待する姿で、それに向けてシェアが守れるように生産能力はしっかり準備していきたいと考えている。小型と中圧では同じ 1 個でも生産負荷が随分違うので、能力の増強も個数ではなく生産能力ベースとしている。20F と同じくらいはしっかり継続したい。

【基地局】

Q. 米中摩擦で、基地局の技術面はどのような影響を受けるか？アンテナの数が減ったり、技術的に少し戻るのか？

A. 当初は中華圏最大手メーカーが中心で、5Gの基地局のメインはTRX 64×64と非常にアンテナサイズが大きいものが想定されていたが、実際に流れているものは32×32以下の小さなものになっている。契約者の数を当初より少し抑え気味に読まれていると思う。部品需要は当初想定していたより低くなっている。5Gのsub6のインフラの敷設は、まず中国でスタートして、日・米・韓で想定通り進んでいて、来年以降は加速していく。米国や日本は五輪やイベントをベースに、ミリ波の基地局が相当狭い間隔で敷設される。技術トレンドとしては、中華圏最大手メーカーと欧米大手でアクティブ素子は変わるけど、アーキテクチャは変わらないので、標準的な部品の展開ができる。

当Q & Aに記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります。これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。

(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当Q & Aに記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。